

提升台灣資通訊及IC產業軟體開發資安研討會

中美貿易戰持續延燒，晶片的安全成為矚目焦點，台灣是半導體產業主要國家，晶片與產品安全品質是國際市場致勝的關鍵。

您是否知道國際網通與3C大廠開始注重晶片供應鏈安全？

您是否知道國內已有晶片設計公司被要求導入軟體安全成熟度模型及國際資安標準？

當客戶要求您提出產品的安全開發流程做法，您要如何因應？您覺得現在沒有需求，但當生意上門客戶要求通過國際資安標準或評測，您是否已經有所準備？

如果想知道這些問題答案，請報名參加資策會資安所於今年10、11月舉辦的「提升台灣資通訊及IC產業軟體開發資安研討會」，您不僅可得到上述答案，並有機會獲得免費諮詢軟體安全成熟度自評、輔導建構「軟體安全成熟度模型」及價值**150萬**原廠查驗。

不論您未來向東或向西發展，有了BSIMM或其他資安認證，將大大增加您公司產品進軍國際供應鏈的機會。

機會難得，請快報名！

誠摯邀請您參與「提升台灣資通訊及IC產業軟體開發資安研討會」。本次研討會活動資訊如下：

活動日期與地點

台南場：109年10月29日(四)南科商務會館201會議室(台南市新市區南科三路26號2F)

台中場：109年10月30日(五)中科管理局工商大樓702會議室(台中市西屯區中科路2號7F)

新竹場：109年11月04日(三)集思竹科會議中心羅西尼廳(新竹市東區工業東二路1號4F)

線上報名請點選此處： [10/29台南場](#) [10/30台中場](#) [11/04新竹場](#)

時 間	議 程	主講者
13:30~14:00	報 到	
14:00~14:10	貴賓致詞	
14:10~15:00	IC設計業軟體安全議題及國際資安標準 (IEC62443/FIPS/CC/BSIMM)	資策會資安所/安華聯網
15:00~15:20	軟體安全成熟度模型經驗分享	Synopsys
15:20~15:40	休息交流時間	
15:40~16:00	軟體安全成熟度作業說明	資策會資安所
16:00~16:20	安全軟體開發的導入與建置	華苓科技

注意事項：

- 主辦單位保留更改之權利
- 客服信箱：楊小萍小姐(ysp@iii.org.tw)，電話：(02)6607-8984
- 為尊重智慧財產權，研討會全程禁止拍照、錄音或錄影

主辦單位：經濟部 技術處

執行單位：財團法人資訊工業策進會 資安科技研究所

協辦單位：台灣區電機電子工業同業公會(TEEMA)、國際半導體產業協會(SEMI Taiwan)、台灣半導體協會(TSIA)、台灣物聯網協會(TIOTA)、中華民國資訊軟體協會(CISA)、台北市電腦商業同業公會(TCA)、台中市電腦商業同業公會(TCCA)、高雄市電腦商業同業公會(KCA)、台南市電腦商業同業公會(TNCCA)、DIGITIMES